

製品概要

インテル® NOR 型フラッシュメモリー

インテル® エンベデッド・フラッシュ・メモリー (J3 v. D)

組込み機器向けにパフォーマンス、バリュー、
スケーラビリティで業界標準を確立



製品の概要

最先端の 130nm プロセス技術で製造されたインテル® エンベデッド・フラッシュ・メモリー (J3 v. D) は、Intel StrataFlash® メモリー (J3) の従来のデザインにドロップイン対応のアップグレード・パスを提供します。インテル® エンベデッド・フラッシュ・メモリー製品群は 32Mb、64Mb、128Mb の容量をラインナップし、組込み機器に最適であり、2012 年¹までサポートの予定です。

8 ワードと 4 ワード両方のページモード機能を備え、標準的なフラッシュ・メモリー・デバイスで非同期モードの最大 3 倍以上の読み取り速度を実現します。インテル® エンベデッド・フラッシュ・メモリーは、Intel XScale® テクノロジー・ベースのプロセッサに加え、主要な組込み機器向けチップセット・メーカーの製品にグルーレスで対応可能な高性能なインターフェイスを提供します。また、インテル® エンベデッド・フラッシュ・メモリーでは、セキュリティ機能が強化されているため、フラッシュ・メイン・アレイの任意のブロックを一時的または永久にロックできます。

コードとデータ管理ソフトウェア

インテル® フラッシュ・ソフトウェアは、各種組込み機器向けオペレーティング・システムにファイルシステムおよびブロック・デバイス・ドライバーを提供します。インテル® エンベデッド・フラッシュ・メモリーとライセンス料無料で提供されるインテル® フラッシュ・ソフトウェア・ソリューションを組み合わせれば、コード実行とデータ・ストレージの機能をシングルチップで実行でき、実装も簡単です。

さまざまなパッケージオプション

インテル® エンベデッド・フラッシュ・メモリーには TSOP パッケージと Easy BGA パッケージがあり、どちらのパッケージタイプでも標準パッケージに加え鉛フリーパッケージを用意しています。56 リード TSOP パッケージは既存のメモリーデバイスからの容易な移行が可能であり、64 ボール Easy BGA パッケージには SOP の信頼性やチップスケール・パッケージ・サイズでの専有面積の長期的な互換性という利点があります。

製品の特長

- 2.7V ~ 3.6V Vcc 動作
- 32Mb、64Mb、128Mb の容量に対応
- 8ワードと4ワードのページモードにより高速の読み出し性能を発揮：
64Kb/s
- TSOP パッケージと Easy BGA パッケージを用意
- 鉛パッケージと鉛フリーパッケージを用意
- 設定可能な x8 または x16 の I/O
- ブロックロック機能に対応した設定可能なレジスター
- 書き込み / 消去サスペンド機能およびサポート
- ライセンス料無料でソフトウェア・サポートを提供
- -40°C ~ +85°C の拡張動作温度に完全対応
- 実績ある信頼性: 100,000 サイクルをサポート

関連資料とツール

J3 v. D 関連資料の最新版は、www.intel.com/design/flash/ (英語) にアクセスし、左側のナビゲーションから“Documentation”をクリックしてご覧ください。

機能	利点
32Mb、64Mb、128Mb の容量に対応	従来のデザインに幅広い容量の選択肢を提供
56 リード TSOP パッケージ、鉛および鉛フリー	既存のメモリーデバイスからの容易な移行をサポート
64 ボール Easy BGA パッケージ、鉛および鉛フリー	長期に渡るサイズと専有面積の互換性。56 リードの 50% のサイズ
設定可能なレジスターとブロック・ロック・ビット	必要とする保護レベルに柔軟に対応。一時的、半永久的、永久的なブロックロック機能を OEM でプログラミング可能。デバイスの追跡、ライセンス管理、システム認証に対応
CFI (Common Flash Interface) 対応	将来の製品との互換性を確保
ページ・モード・インターフェイス、8ワードおよび4ワード	ページ・アクセス・モードにより最大3倍の読み出し速度
充実したインテル® フラッシュ・ソフトウェア	製品の市場投入期間を大幅に短縮。各 OEM の環境にも容易に移植可能

詳細は、<http://www.intel.com/design/flash/> (英語) をご覧ください。

¹ 他のすべての製品と同様、将来のビジネス状況により、特定の製品に対する製造サポートを継続するためのインテルの決定は変更される場合があります。

本資料に掲載されている情報は、インテル製品の概要説明を目的としたものです。本資料は、明示されているか否かにかかわらず、また禁反言によるとらざりかかわらず、いかなる知的財産権のライセンスを許諾するためのものではありません。製品に付属の売買契約書『Intel's Terms and Conditions of Sale』に規定されている場合を除き、インテルはいかなる責を負うものではなく、またインテル製品の販売や使用に関する明示または黙示の保証（特定目的への適合性、商品性に関する保証、第三者の特許権、著作権、その他、知的所有権を侵害していないことへの保証を含む）にも一切応じないものとします。インテル製品は、医療、救命、延命措置などの目的への使用を前提としたものではありません。インテル製品は、予告なく仕様や説明が変更される場合があります。

インテル® エンベデッド・フラッシュ・メモリーと Intel StrataFlash®メモリー (J3) には、エラッタと呼ばれる設計上の不具合が含まれている可能性があり、公表されている仕様とは異なる動作をする場合があります。現在確認済みのエラッタについては、インテルまでお問い合わせください。

Intel、インテル、Intel ロゴ、Intel. さあ、その先へ。、Intel. さあ、その先へ。ロゴ、Intel StrataFlash、Intel XScale は、アメリカ合衆国およびその他の国における Intel Corporation またはその子会社の商標または登録商標です。

* その他の社名、製品名などは、一般に各社の表示、商標または登録商標です。

インテル株式会社

〒300-2635 茨城県つくば市東光台 5-6
<http://www.intel.co.jp/>

©2006 Intel Corporation. 無断での引用、転載を禁じます。
2006年9月

308275-002JA
JPN/0609/1K/SE/FPG/TS

